GaN基板上AIGaN/GaN HEMTの素子特性に バッファ層へのCまたはFeドーピングが及ぼす影響

Effect of C or Fe doping to buffer layer on performance of AlGaN/GaN HEMT on GaN substrate

豊田工業大学, ○(M2)近藤 孝明, (B)東中川 洋幸, 岩田 直高

Toyota Technological Institute, °Takaaki kondo, Hiroyuki Higashinakagawa, Naotaka Iwata

E-mail: sd18414@toyota-ti.ac.jp

AlGaN/GaN 高電子移動度トランジスタ (HEMT)は、低オン抵抗と高耐圧特性を示し、電力制御への利用が期待されている.一般にAlGaN/GaN HEMTはSiやSiC基板上に作製されるが、基板とGaNの格子不整合による結晶欠陥が生じる.そのために厚いバッファ層が欠かせないばかりではなく、本来の特性が示せていない.そこで、GaN基板上のAlGaN/GaN HEMTが注目されている[1].現在、GaNバッファ層の絶縁性を得るためには不純物のドーピングが一般的である.しかし、このドーピングがHEMTの特性へ与える影響は明らかにされていない.本研究の目的は、GaNバッファ層へのドーピングが素子特性に及ぼす影響を明らかにすることである.

使用したウエハは、Al_{0.22}GaN/GaN/GaNバッファ構造をGaN基板上に形成したものである.GaNバッファ層へ炭素をドーピングしたCドープ素子と,鉄をドーピングしたFeドープ素子を検討した.素子の作製プロセスを以下に示す.ウエハ上へSiO₂/SiN膜を堆積した後,ドライエッチングによる素子分離を行った.次にAu/Ti/Al/Ti構造のオーミック電極を形成し,合金化熱処理を施した.その後Au/Ni構造のゲート電極を形成した.最後にSiN膜を原子層堆積法により堆積した.

試作したHEMTの電子移動度は1900cm²/V・sであり、Si基板上の移動度よりも高い[2]. これは、GaN基板上HEMTチャネルの結晶欠陥密度がSi基板上よりも低く、電子の散乱が少ないことを示唆する. 次に、トランジスタ特性を測定したところ、ドレイン電流(I_D) 480mA/mmをCドープ素子で、400mA/mmをFeドープ素子で得た. なお、しきい値電圧はともに-1.5Vであった. 続いて、バッファ層からチャネルに変調をかけて、ドーピングの影響を評価した. Fig.1に、サイドゲート構造を持つHEMTの断面図と上面写真を示す. サイドゲートは、素子領域を取り囲むようにバッファ層の上部

に形成した。Fig.2に、ドレイン電圧(V_{DS})6.0Vを印加した状態で、サイドゲートと接地間に負から正のバイアス電圧を掃引したときの I_D 特性を示す。ソースとゲートは接地した。Cドープ素子では、サイドゲート電圧の掃引に伴って I_D が上昇した。そして、サイドゲート電圧が-8V付近でゲート電圧(V_{GS})0Vを印加したHEMTの I_D とほぼ等しい値を示し、それ以降は一定となった。一方Feドープ素子は、サイドゲート電圧の値にかかわらず V_{GS} =0Vを印加したHEMTの I_D を示した。すなわち、Cドープ素子ではバッファ層を通してチャネルが変調されたのに対し、Feドープ素子は変調されなかった。よって、Feドープバッファ層は外部からの電圧変動に強いことが判明した。

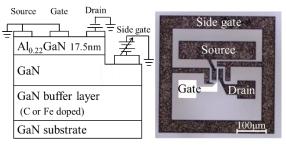


Fig.1. Structure and top view of HEMT with side gate.

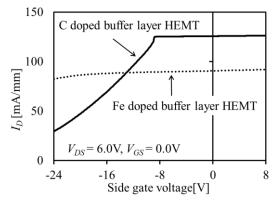


Fig.2. *ID* characteristics of the side gate HEMTs. 本研究は文部科学省「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発」の委託を受けたものです.

- [1] T. J. Anderson et al., IEEE EDL 37, 28 (2016).
- [2] T. Kondo et al., JJAP 59, SAAD02 (2020).